

# 策略聯盟兩岸晶圓代工競爭優勢之關鍵因素

## Key Factors for Competitive Advantages of Cross-strait IC Foundry in Strategic Alliance

黃國平<sup>1</sup> Kevin P. Hwang 陳弘法<sup>2</sup> Hug-Fa Chen 王明坤<sup>1</sup> Ming-Kuen Wang  
國立成功大學交通管理科學系 暨電信管理研究所 國立成功大學經營管理研究所 國立成功大學交通管理科學系 暨電信管理研究所

<sup>1</sup>Department of Transportation and Communication Management Science, National Cheng Kung University and <sup>2</sup>Institute of Business Administration, National Cheng Kung University

(Received September 23, 2009; Final Version March 1, 2010)

**摘要：**在全球經濟衰退的 2008/9 年，中國是少數經濟保持穩定增長的國家，台灣晶圓代工雖仍居世界第一，然而中國藉由政策與大量資金發展半導體產業，建立上、下游產業鏈、以自有 3G 產業標準扶持 IC 設計業，因此在兩岸關係漸趨和緩的情境下，本論文以德菲法確立問卷準則再透過分析層級程序法探討兩岸晶圓代工競爭優勢，重新檢視兩岸晶圓代工產業可以發展的策略聯盟。分析台灣、中國業者的中高階主管及相關支援業者所做的 52 份決策問卷顯示波特鑽石體系理論 5 個構面的排序為：(1)生產因素，(2)需求條件，(3)週邊相關及支援產業表現，(4)企業的策略、結構與同業競爭能力，(5)政府。發現在 17 個次準則中，關鍵因素分別為：公司治理與獎酬制度，高素質研發與技術人才，完整緊密合作的上下游供應鏈體系與技術研發創新能力。在策略聯盟上，由於中國快速崛起，台灣必須更積極與國際接軌，擴展、深化晶圓代工價值鏈，透過公司治理與獎酬制度促成價值鏈上 IC 設計與服務創新，長期居此項領導地位，短期要充份以中國內需市場為標的，發展兩岸間同業非競爭聯盟機制共同來創造兩岸雙贏。

**關鍵字：**晶圓代工競爭優勢、分析層級程序法、策略聯盟